

# 半硬化熱伝導性シリコングリース

## Half-Cure Thermal Conductive Silicone Grease

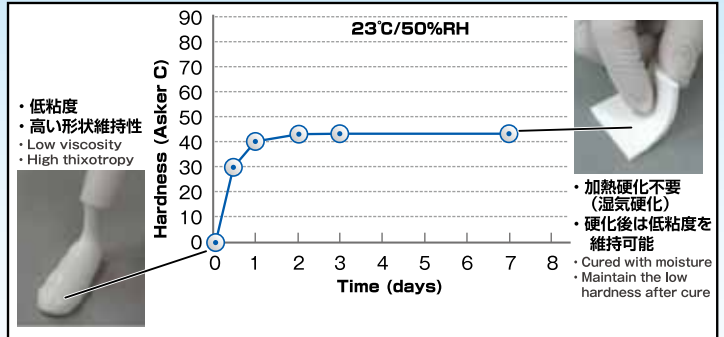
# G-1000

### ● 一般特性 Genral Properties

項目 Parameter	製品名 Grade	G-1000
硬化形式 Cure System		1液縮合タイプ One-component condensation
外観 Appearance		白色グリース White grease
粘度; Viscosity 25°C	Pa·s *1	80
比重 Specific Gravity		3.04
揮発分 Volatile Content 150°C×24hrs	%	0.58
絶縁破壊の強さ Dielectric Breakdown Strength 0.25mm	kV	3.6
指触乾燥時間 Tack-free Time	min	3
硬さ(硬化後) Hardness(after curing) アスカー-C Asker C		40
引張せん断接着強さ(AI/AI) Tensile Lap-shear Strenght(AI/AI)	Mpa	0.03
熱伝導率 Thermal Conductivity	W/m·K	2.4

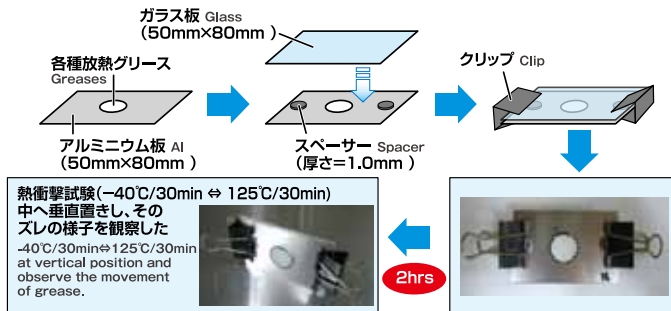
(規格値ではありません Not specified values)

### ● 硬化性データ Curing Speed



### ● 垂れ試験 Grease Movement Test

#### ● 試験方法 Method



#### ● 試験結果 Result

製品名 Grade	G-747	G-1000
粘度 Viscosity Pa·s	50	80
100 cycles [厚み Thickness = 1.0mm, -40°C/30min ⇄ 125°C/30min]		
250 cycles [厚み Thickness = 1.0mm, -40°C/30min ⇄ 125°C/30min]	テスト終了 Finished	

# 熱伝導性シリコングリース

## Thermal Interface Silicone Grease

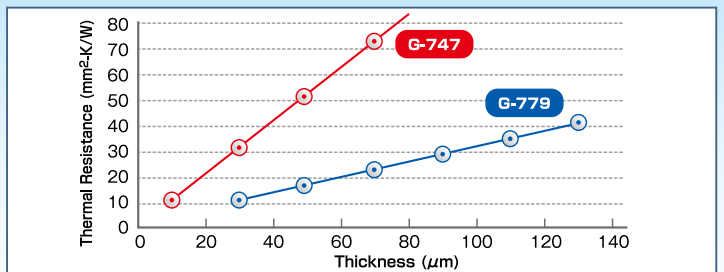
# G-779

### ● 一般特性 Genral Properties

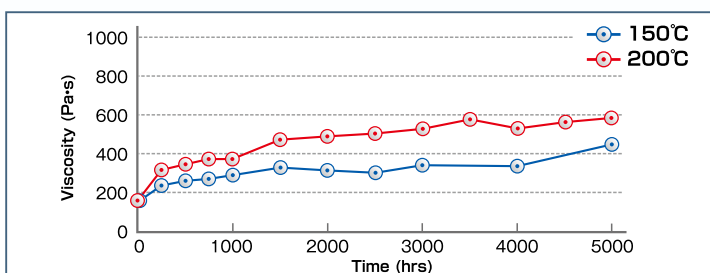
項目 Parameter	製品名 Grade	G-779
外観 Appearance		白色グリース White Grease
粘度; Viscosity 25°C	Pa·s	160
比重 Specific Gravity		3.21
揮発分 Volatil Center	%	0.18
絶縁破壊の強さ Dielectric Breakdown Strength 0.25mm	kV	3.2
熱伝導率 Thermal Conductivity	W/m·K	2.95
熱抵抗 Thermal Resistance	mm <sup>2</sup> ·K/W	10.6
BLT	μm	25

(規格値ではありません Not specified values)

### ● 厚みと熱抵抗 Thickness vs. Thermal Resistance



### ● 耐熱性 High Temperature Stability



### ● 圧力と熱抵抗 Pressure vs. Thermal Resistance & BLT

